

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2002年10月23日

出願番号 Application Number: 特願2002-308970

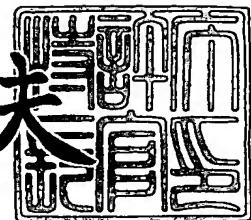
[ST. 10/C]: [JP 2002-308970]

出願人 Applicant(s): 信越半導体株式会社  
株式会社ナノテコ

2003年9月16日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



(●)

【書類名】 特許願

【整理番号】 AX0222752S

【提出日】 平成14年10月23日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 33/00

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会  
社 半導体磯部研究所内

【氏名】 能登 宣彦

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県安中市磯部二丁目13番1号 信越半導体株式会  
社 磯部工場内

【氏名】 山田 雅人

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市枡形6-5-2 フローラルガーデン向  
ヶ丘遊園308

【氏名】 野崎 真次

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区久が原4-5-7

【氏名】 内田 和男

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県鶴ヶ島市鶴が丘27-16-606

【氏名】 森崎 弘

【特許出願人】

【持分】 009/010

【識別番号】 000190149

【氏名又は名称】 信越半導体株式会社

## 【特許出願人】

【持分】 001/010

【識別番号】 501045021

【氏名又は名称】 株式会社ナノテコ

## 【代理人】

【識別番号】 100095751

【弁理士】

【氏名又は名称】 菅原 正倫

【電話番号】 052-212-1301

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003388

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9901665

【包括委任状番号】 0201235

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 発光素子の製造方法及び発光素子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

発光層成長用基板上に化合物半導体よりなる発光層部をエピタキシャル成長させる発光層部成長工程と、

導電性基板の第一主表面側に金属層を形成する金属層形成工程と、

前記発光層部の第一主表面側に接合用透明導電性酸化物層を形成する接合用透明導電性酸化物層形成工程と、

前記導電性基板と前記発光層部とを、前記金属層と前記接合用透明導電性酸化物層とが接するように貼り合わせる貼り合わせ工程と、

をこの順に行なうことを特徴とする発光素子の製造方法。

【請求項 2】 前記貼り合わせ工程において、前記接合用透明導電性酸化物層と前記金属層との間で貼り合わせを行なうことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 3】 貼り合わせ後の前記金属層の、前記接合用透明導電性酸化物層と接する部分を Au 系金属層とすることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の発光素子の製造方法。

【請求項 4】 前記接合用透明導電性酸化物層を ITO 層とし、前記金属層の、前記接合用透明導電性酸化物層と接する部分を、Sn を含有した Au 系金属層とすることを特徴とする請求項 3 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 5】 前記導電性基板を Si 基板とし、80°C 以上 360°C 以下の貼り合わせ熱処理により、前記 Si 基板と接する Au 系金属層を介して該 Si 基板を前記発光層部に貼り合わせることを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の発光素子の製造方法。

【請求項 6】 前記接合用透明導電性酸化物層形成工程に先立って、該接合用透明導電性酸化物層の接合抵抗を減ずるためのコンタクト層を、前記発光層部の前記第一主表面側に形成するコンタクト層形成工程を有することを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項に記載の発光素子の製造方法。

【請求項 7】 前記接合用透明導電性酸化物層を形成するのに先立って、前記発光層部の前記第一主表面側に GaAs 層を形成し、その後、前記接合用透明導電性酸化物層としての ITO 層を当該 GaAs 層と接するように形成した後、熱処理することにより、前記 ITO 層から前記 GaAs 層に In を拡散させて、In を含有した GaAs よりなるコンタクト層となすことを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項に記載の発光素子の製造方法。

【請求項 8】 前記導電性基板を Si 基板とし、80℃以上 360℃以下の貼り合わせ熱処理により、前記 Si 基板と接する Au 系金属層を介して該 Si 基板を前記発光層部に貼り合わせ、その後、前記 GaAs 層に In を拡散させる前記熱処理を行なうことを特徴とする請求項 7 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 9】 前記 GaAs 層に In を拡散させる前記熱処理を、600℃以上 750℃以下の温度で 5 秒以上 120 秒以下実施することを特徴とする請求項 7 又は 8 に記載の発光素子の製造方法。

【請求項 10】 導電性基板の一方の主表面上に、金属層と、該金属層と接する接合用透明導電性酸化物層と、化合物半導体よりなる発光層部と、該発光層部に電圧を印加するための電極とがこの順序にて形成されてなることを特徴とする発光素子。

【請求項 11】 前記金属層の、前記接合用透明導電性酸化物層と接する部分を Au 系金属層とすることを特徴とする請求項 10 記載の発光素子。

【請求項 12】 前記接合用透明導電性酸化物層を ITO 層とし、前記金属層の、前記接合用透明導電性酸化物層と接する部分を、Sn を含有した Au 系金属層とすることを特徴とする請求項 11 記載の発光素子。

【請求項 13】 前記接合用透明導電性酸化物層と前記発光層部との間に、前記接合用透明導電性酸化物層の接合抵抗を減ずるためのコンタクト層が、前記接合用透明導電性酸化物層と接するように形成されてなることを特徴とする請求項 10 ないし 12 のいずれか 1 項に記載の発光素子。

【請求項 14】 前記発光層部の、前記導電性基板に面しているのと反対側の主表面が、光取出面側電極を兼ねた電極用透明導電性酸化物層により覆われてなり、前記発光層部と前記電極用透明導電性酸化物層との間に、該電極用透明導

電性酸化物層の接合抵抗を減ずるためのコンタクト層が、該電極用透明導電性酸化物層に接するように配置されたことを特徴とする請求項 9 ないし 13 のいずれか 1 項に記載の発光素子。

【請求項 15】 前記電極用透明導電性酸化物層の主表面上に、前記発光層部に対して電圧を印加するための金属電極が、該主表面の一部領域を覆う形で形成され、

前記電極用透明導電性酸化物層は、金属電極の直下領域からなる第一領域と残余の第二領域とを有し、前記コンタクト層は、前記第二領域において、前記第一領域よりも形成面積率が大きい請求項 14 記載の発光素子。

【請求項 16】 前記第一領域に前記コンタクト層が形成されていないことを特徴とする請求項 15 記載の発光素子。

【請求項 17】 前記第二領域において少なくとも、前記コンタクト層の形成領域と非形成領域とが混在してなることを特徴とする請求項 15 又は 16 に記載の発光素子。

【請求項 18】 前記コンタクト層は、前記透明導電性酸化物層との接合界面において Al を含有せず、かつバンドギャップエネルギーが 1.42 eV より小さい化合物半導体からなることを特徴とする請求項 14 ないし 17 のいずれか 1 項に記載の発光素子。

【請求項 19】 前記コンタクト層を構成する化合物半導体は、前記透明導電性酸化物層との接合界面において  $In_x Ga_{1-x} As$  ( $0 < x \leq 1$ ) であることを特徴とする請求項 18 記載の発光素子。

【請求項 20】 前記透明導電性酸化物層が ITO 層であり、前記コンタクト層は、前記透明導電性酸化物層との接合界面において  $In_x Ga_{1-x} As$  ( $0 < x \leq 1$ ) であり、かつ厚さ方向における In 濃度分布が、前記 ITO 層から厚さ方向に遠ざかるにつれ連続的に減少するものとされたことを特徴とする請求項 14 又は 19 に記載の発光素子。

【請求項 21】 前記コンタクト層の、前記透明導電性酸化物層に接しているのと反対側の主表面上に、中間層を介して前記発光層部が結合されてなり、かつ、該中間層が、前記発光層部と前記コンタクト層との間のバンドギャップエネ

ルギーを有する化合物半導体よりなることを特徴とする請求項 14 ないし 20 のいずれか 1 項に記載の発光素子。

【請求項 22】 前記発光層部が、  $(Al_xGa_{1-x})_yIn_{1-y}P$  (ただし、  $0 \leq x \leq 1$ ，  $0 \leq y \leq 1$  ) よりなり、前記中間層を、  $AlGaAs$  層、  $GaInP$  層及び  $AlGaInP$  層のうち少なくとも一つを含むものとして形成することを特徴とする請求項 21 記載の発光素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は発光素子の製造方法及び発光素子に関する。

【0002】

【従来の技術】

【特許文献 1】

特開平 7-66455 号公報

【特許文献 2】

特開 2001-339100 号公報

【0003】

発光ダイオードや半導体レーザー等の発光素子に使用される材料及び素子構造は、長年にわたる進歩の結果、素子内部における光電変換効率が理論上の限界に次第に近づきつつある。従って、一層高輝度の素子を得ようとした場合、素子からの光取出し効率が極めて重要となる。例えば、  $AlGaInP$  混晶により発光層部が形成された発光素子は、薄い  $AlGaInP$  (あるいは  $GaInP$ ) 活性層を、それよりもバンドギャップの大きい n 型  $AlGaInP$  クラッド層と p 型  $AlGaInP$  クラッド層とによりサンドイッチ状に挟んだダブルヘテロ構造を採用することにより、高輝度の素子を実現できる。このような  $AlGaInP$  ダブルヘテロ構造は、  $AlGaInP$  混晶が  $GaAs$  と格子整合することを利用し、  $GaAs$  単結晶基板上に  $AlGaInP$  混晶からなる各層をエピタキシャル成長させることにより形成できる。そして、これを発光素子として利用する際には、通常、  $GaAs$  単結晶基板をそのまま素子基板として利用することも多い。

しかしながら、発光層部を構成するAlGaInP混晶はGaAsよりもバンドギャップが大きいため、発光した光がGaAs基板に吸収されて十分な光取出し効率が得られにくい難点がある。この問題を解決するために、半導体多層膜からなる反射層を基板と発光素子との間に挿入する方法（例えば特許文献1）も提案されているが、積層された半導体層の屈折率の違いを利用するため、限られた角度で入射した光しか反射されず、光取出し効率の大幅な向上は原理的に期待できない。

#### 【0004】

そこで、特許文献2をはじめとする種々の公報には、成長用のGaAs基板を剥離して、補強用の導電性基板を、反射層を兼ねたAu層等の金属層を介して剥離面に貼り合わせる技術が開示されている。金属層は反射率が高く、また、反射率の入射角依存性あるいは波長依存性が小さい利点がある。

#### 【0005】

##### 【発明が解決しようとする課題】

金属層を発光層部に接合する場合に、接触抵抗低減のための合金化層を介在させる必要がある。この合金化層は、発光層部との合金化により接触抵抗低減効果を顕著に発揮する組成を有した金属層（以下、コンタクト金属層という）を発光層部上に形成した後、合金化熱処理を行うことにより形成される。例えば、AlGaInP発光層部のn型クラッド層側に金属層を形成する場合、コンタクト金属層はAuGe合金等で構成できる。しかしながら、合金化の進んだ領域は反射率が著しく損なわれるので、金属層反射により光取出効率を高める効果が必ずしも十分に得られない問題がある。

#### 【0006】

本発明の課題は、金属層を反射層として利用することにより、素子からの光取出し効率が良好であり、金属層と発光層部との合金化による反射率低下の心配がない発光素子の製造方法と、それにより得られる発光素子とを提供することにある。

#### 【0007】

##### 【課題を解決するための手段及び作用・効果】

上記の課題を解決するために、本発明の発光素子の製造方法は、  
発光層成長用基板上に化合物半導体よりなる発光層部をエピタキシャル成長させ  
る発光層部成長工程と、  
導電性基板の第一主表面側に金属層を形成する金属層形成工程と、  
発光層部の第一主表面側に接合用透明導電性酸化物層を形成する接合用透明導  
電性酸化物層形成工程と、  
導電性基板と発光層部とを、金属層と接合用透明導電性酸化物層とが接するよ  
うに貼り合わせる貼り合わせ工程と、  
をこの順に行なうことを特徴とする。

#### 【0008】

また、本発明の発光素子は、導電性基板の一方の主表面上に、金属層と、該金  
属層と接する接合用透明導電性酸化物層と、化合物半導体よりなる発光層部と、  
該発光層部に電圧を印加するための電極とがこの順序にて形成されてなることを  
特徴とする。

#### 【0009】

上記本発明によると、導電性基板を、金属層を介して貼り合わせる発光層部の  
第一主表面側に接合用透明導電性酸化物層を形成し、この接合用透明導電性酸化  
物層に金属層を接合するようにした。これにより、金属層と発光層部をなす化  
合物半導体との合金化が抑制され、金属層の反射率を高めることができる。

#### 【0010】

貼り合わせ工程においては、接合用透明導電性酸化物層と金属層との間で貼り  
合わせを行なうことができる。この工程は、接合用透明導電性酸化物層を、導電  
性基板側の金属層に直接張り合わせるので工程が簡略化される利点がある。

#### 【0011】

金属層は、（貼り合わせ後の）金属層の、接合用透明導電性酸化物層と接する  
部分をAu系金属層（Auを主成分（50質量%以上）とするもの）とすること  
ができる。Au系金属層は接合用透明導電性酸化物層との反応を起こしにくく、  
貼り合わせ後も高反射率を維持しやすい利点がある。なお、接合用透明導電性酸  
化物層を後述のITO（Indium Tin Oxide）層とする場合、金属層の、接合用透

明導電性酸化物層と接する部分を、Snを含有したAu系金属層（例えばAu-Sn合金）とすれば、ITO層との接合強度を高めることができ、また、接触抵抗もより低減することができる。

#### 【0012】

この場合、導電性基板としてはAlやCu等の金属基板を使用することもできるが、安価なSi（シリコン）基板（多結晶基板又は単結晶基板：前者は特に安価である）を用いると、コスト削減上の効果が大きく、より有利である。貼り合わせ面に介在させる金属層としては、Au系金属層（Auを主成分（50質量%以上）とするもの：例えばAu層）が、高反射率を実現できるので好適である。この場合、Au系金属層を介したSi基板と発光層部との貼り合せは、80℃以上360℃以下の貼り合わせ熱処理により行なうことが望ましい。熱処理温度が80℃未満では貼り合わせ強度が不十分となる。また、360℃（Au-Si二元系共晶温度は約363℃）を超えると金属層側のAuと基板側のSiとの共晶反応が著しくなり、金属層の反射率が大幅に低下してしまう不具合につながる。

#### 【0013】

次に、発光層成長用基板は、例えば導電性基板の貼り合わせ後に、発光層部から剥離することができる。そして、発光層成長用基板の剥離により露出した発光層部側の主表面を第二主表面として、当該第二主表面を、光取出面側電極を兼ねた電極用透明導電性酸化物層により被覆する電極用透明導電性酸化物層工程を実施することができる。これにより、発光層部の、導電性基板に面しているのと反対側の主表面が、光取出面側電極を兼ねた電極用透明導電性酸化物層により覆われた発光素子が得られる。このように発光素子を構成すると、電極用透明導電性酸化物層が形成された光取出面側に、裏面側に向かう発光を反射により重畠させることができ、光取出し効率を向上させることができる。しかも、光取出面側には、通常の電流拡散層よりも光透過率と導電性が高く、かつ厚さの小さい電極用透明導電性酸化物層が形成されることで、その優れた電流拡散効果とも相俟って、素子の光取出し効率がさらに向上する。

#### 【0014】

透明導電性酸化物層は、例えばITOにて構成できる。ITOは、酸化スズを

ドープした酸化インジウム膜であり、酸化スズの含有量を1～9質量%とすることで、電極層の抵抗率を $5 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の十分低い値とすることができる。なお、ITO電極層以外では、ZnO電極層が高導電率であり、本発明に採用可能である。また、酸化アンチモンをドープした酸化スズ（いわゆるネサ）、 $\text{Cd}_2\text{SnO}_4$ 、 $\text{Zn}_2\text{SnO}_4$ 、 $\text{ZnSnO}_3$ 、 $\text{MgIn}_2\text{O}_4$ 、酸化イットリウム（Y）をドープした $\text{CdSb}_2\text{O}_6$ 、酸化スズをドープした $\text{GaInO}_3$ なども透明導電性酸化物層の材質として使用することができる。これらの導電性酸化物は可視光に対して良好な透過性を有し（つまり、透明であり）、発光層部への電圧印加用電極として用いる場合、光の取出しを妨げない利点がある。また、電極用透明導電性酸化物層に関しては、その上に形成されるボンディングパッドなどの金属電極を介して素子駆動用の電圧を印加したとき、電流を面内に広げて発光を均一化し高効率化する役割も担う。これらの透明酸化物電極は、公知の気相成膜法、例えば化学蒸着法（chemical vapor deposition：CVD）あるいはスパッタリングや真空蒸着などの物理蒸着法（physical vapor deposition：PVD）、あるいは分子線エピタキシャル成長法（molecular beam epitaxy：MBE）にて形成することができる。例えば、ITO層やZnO電極層は高周波スパッタリング又は真空蒸着により製造でき、また、ネサ膜はCVD法により製造できる。また、これら気相成長法に代えて、ゾルゲル法など他の方法を用いて形成してもよい。

### 【0015】

ただし、貼り合わせ熱処理の後、電極用透明導電性酸化物層を第二主表面（発光層部成長用基板の剥離された主表面）に形成する場合は、成長温度の比較的低いスパッタリングにて形成することが、金属層側のAuと基板側のSiとの共晶反応を抑制する観点において望ましい。従って、透明導電性酸化物の材質は、スパッタリングにより均質で高導電性のものを特に得やすいITOを採用することが望ましい。換言すれば、Au系金属層を介してSi基板と発光層部とが貼り合わされ、かつ、電極用透明導電性酸化物層としてスパッタリングによりITO層を形成することで、Au系金属層への共晶形成が抑制され、その反射率を大幅に高めることが可能となるのである。

## 【0016】

次に、ITO層等の透明導電性酸化物層は、発光層部側の化合物半導体層と直接接合しようとしたとき、良好なオーミック接合が必ずしも形成されず、接触抵抗に基づく直列抵抗増大により発光効率が低下することがある。しかしながら、本発明の発光素子は、透明導電性酸化物層の接触抵抗を減ずるためのコンタクト層を、透明導電性酸化物層に接するように配置することにより、透明導電性酸化物層の接触抵抗を下げることができる。具体的には、本発明の発光素子は、接合用透明導電性酸化物層と発光層部との間に、接合用透明導電性酸化物層の接合抵抗を減ずるためのコンタクト層が、接合用透明導電性酸化物層と接するように形成された構造とすることができる。この場合、接合用透明導電性酸化物層形成工程に先立って、該接合用透明導電性酸化物層の接合抵抗を減ずるためのコンタクト層を、発光層部の第一主表面側に形成するコンタクト層形成工程を実施する。

## 【0017】

また、発光層部の導電性基板に面しているのと反対側の主表面が、光取出面側電極を兼ねた電極用透明導電性酸化物層により覆われてなり、発光層部と電極用透明導電性酸化物層との間に、該電極用透明導電性酸化物層の接合抵抗を減ずるためのコンタクト層が、該電極用透明導電性酸化物層に接するように配置された構造とすることもできる。この場合、電極用透明導電性酸化物層形成工程に先立って、該接合用透明導電性酸化物層の接合抵抗を減ずるためのコンタクト層を、発光層部の第二主表面側に形成するコンタクト層形成工程を実施する。

## 【0018】

次に、電極用透明導電性酸化物層側のコンタクト層は、電極用透明導電性酸化物層との接合界面において、コンタクト層の形成領域と非形成領域とが混在してなることが望ましい。コンタクト層を電極用透明導電性酸化物層の発光層部側への接合面全面を被覆するように形成すると、次のような問題が生ずる場合がある。

- ①電極用透明導電性酸化物層上には、ワイヤボンディング用の金属電極を形成する必要がある。電極用透明導電性酸化物層と発光層部との接触抵抗が、その金属電極の直下領域でも大幅に低くなると、駆動電流ひいては発光が該領域に集中し

やすくなり、発生した光の多くが金属電極により遮蔽されて光取出効率の低下を招く。

②コンタクト層として採用する化合物半導体の材質によっては、コンタクト層が光吸收体として作用し、同様に光取出効率の低下につながる。

### 【0019】

そこで、本発明の発光素子は、電極用透明導電性酸化物層の主表面に、発光層部に対して電圧を印加するための金属電極が、該主表面の一部領域を覆う形で形成され、電極用透明導電性酸化物層が、金属電極の直下領域からなる第一領域と残余の第二領域とを有し、第二領域は第一領域より光取り出し量が多く、コンタクト層は、第二領域において第一領域よりも形成面積率が大きいものとして構成できる。なお、本明細書において各領域のコンタクト層の形成面積率とは、領域中のコンタクト層の合計面積を、領域の全面積により割った比率をいう。該構成によると、光取り出し量が少ないボンディングパッドの直下領域（第一領域）において、光取り出し量が多い残余の領域（第二領域）よりも電極用透明導電性酸化物層の接合界面に形成されるコンタクト層の形成面積率を小さくしたから、第一領域における電極用透明導電性酸化物層の接触抵抗が増大する。その結果、発光素子の駆動電流は、第一領域を迂回して第二領域に流れる成分が大きくなり、光取出効率を大幅に高めることができる。なお、光取り出し量が少ない第一領域には、なるべく発光駆動電流が流れないことが光取出効率向上の観点においては望ましい。従って、第一領域にはコンタクト層が可及的に形成されていないことが望ましい。

### 【0020】

また、本発明の発光素子は、電極用透明導電性酸化物層の接合界面のうち、発光層部からの光を外部へ取り出す量が多い第二領域において少なくとも、コンタクト層の形成領域と非形成領域とが混在してなるものとして構成できる。コンタクト層の形成領域は、分散形成されてなることが好ましい。なお、この第二領域を前記した金属電極の直下領域（第一領域）を除く残余の領域とみなすことで、該第二の構成は前記第一の構成と組み合わせることができる。該構造によると、電極用透明導電性酸化物層の接触抵抗低減のために形成するコンタクト層が、発

光層部からの光を吸収しやすい性質を有している場合においても、コンタクト層の形成領域直下にて発生した光は、これと隣接する非形成領域から漏出することにより、コンタクト層による吸収を抑制することができる。その結果、素子全体としての光取出効率を高めることができる。

#### 【0021】

接合用透明導電性酸化物層あるいは電極用透明導電性酸化物層の、いずれの透明導電性酸化物層との接合界面においても、コンタクト層は、具体的には、Alを含有せず、かつバンドギャップエネルギーが1.42eVより小さい化合物半導体からなるものを好適に採用することができる。このようなコンタクト層を用いることにより、良好なオーミックコンタクトが得られ、また、Al成分酸化による抵抗増加も生じにくい。

#### 【0022】

コンタクト層は、具体的にはInを含有したGaAsを好適に用いることができる。この場合、良好なオーミックコンタクトを得るには、コンタクト層を構成する化合物半導体は、（少なくとも）透明導電性酸化物層との接合界面において、 $In_xGa_{1-x}As$  ( $0 < x \leq 1$ ) であればよい。

#### 【0023】

さらに、接合用透明導電性酸化物層をITO層とする場合、接合用透明導電性酸化物層を形成するのに先立って、発光層部の第一主表面側にGaAs層を形成し、その後、接合用透明導電性酸化物層としてのITO層を当該GaAs層と接するように形成した後、熱処理することにより、ITO層からGaAs層にInを拡散させて、Inを含有したGaAsよりなるコンタクト層となすことができる。また、電極用透明導電性酸化物層をITO層とする場合、電極用透明導電性酸化物層を形成するのに先立って、発光層部の第二主表面にGaAs層を形成し、その後、電極用透明導電性酸化物層としてのITO層を当該GaAs層と接するように形成した後、熱処理することにより、ITO層からGaAs層にInを拡散させて、Inを含有したGaAsよりなるコンタクト層となすことができる。

#### 【0024】

コンタクト層は InGaAs を直接エピタキシャル成長する方法を採用してもよいのであるが、上記の方法を採用すると、次のような利点がある。すなわち、GaAs 層は、例えば AlGaInP よりなる発光層部と格子整合が極めて容易であり、InGaAs を直接エピタキシャル成長する場合と比較して、均質で連続性のよい膜を形成できる。

#### 【0025】

そして、その GaAs 層上に ITO 層を形成した後、熱処理することにより、ITO 層から GaAs 層に In を拡散させてコンタクト層とする。このように熱処理して得られる In を含有した GaAs よりなるコンタクト層は、In 含有量が過剰とならず、発光層部との格子不整合による、発光強度低下などの品質劣化を効果的に防止することができる。GaAs 層と発光層部との格子整合は、発光層部が  $(Al_xGa_{1-x})_yIn_{1-y}P$  (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ ， $0.45 \leq y \leq 0.55$ ) にて構成される場合に特に良好となるので、混晶比 y を上記の範囲に設定して、発光層部 (クラッド層あるいは活性層) を形成することが望ましいといえる。

#### 【0026】

透明導電性酸化物層が ITO 層の場合、上記の熱処理は、コンタクト層の厚さ方向における In 濃度分布が、図 4 の①に示すように、ITO 層から厚さ方向に遠ざかるにつれ連続的に減少するものとなるようにする (つまり、In 濃度分布に傾斜をつける) ことが望ましい。こうした構造は、熱処理により、ITO 側からコンタクト層側へ In を拡散させることにより形成される。

#### 【0027】

このようにして得られる発光素子は、(電極用ないし接合用) 透明導電性酸化物層が ITO 層として形成され、発光層部と ITO 層との間に、コンタクト層が該 ITO 層と接するように形成され、コンタクト層が、透明導電性酸化物層との接合界面において  $In_xGa_{1-x}As$  ( $0 < x \leq 1$ ) であり、かつ厚さ方向における In 濃度分布が、ITO 層から厚さ方向に遠ざかるにつれ連続的に減少するものとなる。

#### 【0028】

このような  $I_n$  濃度分布のコンタクト層を形成することにより、発光層部との格子整合性をより高めることができる。特に、前記発光層部が、 $(Al_xGa_{1-x})_yIn_{1-y}P$  (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ ) により、第一導電型クラッド層、活性層及び第二導電型クラッド層がこの順序にて積層されたダブルヘテロ構造を有するものとして構成されている場合、発光層部側にてコンタクト層の  $I_n$  濃度分布が小さくなれば、発光層部との格子定数差が顕著の縮小し、格子整合性向上効果が大きい。なお、熱処理温度が過度に高くなったり、あるいは熱処理時間が長大化すると、ITO層からの  $I_n$  拡散が過度に進行して、図4の③に示すように、コンタクト層内の  $I_n$  濃度分布が厚さ方向にはほぼ一定の高い値を示すようになり、上記の効果は得られなくなる（一方、熱処理温度が過度に低くなったり、あるいは熱処理時間が過度に短時間化すると、図4の②に示すように、コンタクト層内の  $I_n$  濃度が不足することにつながる）。

### 【0029】

この場合、図4において、コンタクト層の、ITO層との境界位置における  $I_n$  濃度を  $C_A$  とし、これと反対側の境界近傍における  $I_n$  濃度を  $C_B$  としたとき、 $C_B/C_A$  が 0.8 以下となるように調整することが望ましく、該形態の  $I_n$  濃度分布が得られるように、前述の熱処理を行なうことが望ましい。 $C_B/C_A$  が 0.8 を超えると、 $I_n$  濃度分布傾斜による発光層部との格子整合性改善効果が十分に得られなくなる。なお、コンタクト層の厚さ方向の組成分布 ( $I_n$  あるいは  $Ga$  濃度分布) は、層を厚さ方向に徐々にエッチングしながら、二次イオン質量分析 (Secondary Ion Mass Spectroscopy: SIMS)、オージェ電子分光分析 (Auger Electron Spectroscopy)、X線光電子分光 (X-ray Photoelectron Spectroscopy: XPS) などの周知の表面分析方法により測定することができる。

### 【0030】

コンタクト層のITO透明電極層との境界近傍における  $I_n$  濃度は、 $I_n$  と  $Ga$  との合計濃度に対する  $I_n$  の原子比にて、0.1 以上 0.6 以下とされることが望ましく、上記の熱処理もこのような  $I_n$  濃度が得られるように行なうことが望ましい。上記定義による  $I_n$  濃度が 0.1 未満になると、コンタクト層の接触

抵抗低減効果が不十分となり、0.6を超えるとコンタクト層と発光層部との格子不整合による、発光強度低下などの品質劣化が甚だしくなる。なお、コンタクト層のITO透明電極層との境界近傍におけるIn濃度が、InとGaとの合計濃度に対するInの原子比にて、例えば前述の望ましい値（0.1以上0.6以下）を確保できるのであれば、コンタクト層の、ITO透明電極層に面しているのと反対側の境界近傍でのIn濃度CBがゼロとなっていること、つまり、図5に示すように、コンタクト層のITO透明電極層側にInGaAs層が形成され、反対側の部分がGaAs層となる構造となっていても差し支えない。

### 【0031】

ITOは、前述の通り酸化スズをドープした酸化インジウム膜であり、ITO層をGaAs層上に形成し、さらにこれを適正な温度範囲にて熱処理することにより、上記望ましいIn濃度を有したコンタクト層を容易に形成できる。また、この熱処理により、ITO層の電気抵抗率をさらに低減できる。

### 【0032】

この熱処理は、コンタクト層内のIn濃度が過剰とならないよう、なるべく低温で短時間にて行なうことが望ましい。例えば、前述のように、導電性基板をSi基板とし、80°C以上360°C以下の貼り合わせ熱処理により、Si基板と接するAu系金属層を介して該Si基板を発光層部に貼り合わせる場合は、その貼り合わせ熱処理の後で、GaAs層にInを拡散させる上記の熱処理を行なうことが望ましい。そして、該In拡散の熱処理が低温で短時間のものに留まる限り、金属層側のAuと基板側のSiとの共晶反応を十分抑制できる利点が新たに生ずるのである。

### 【0033】

上記In拡散の熱処理は、600°C以上750°C以下にて行なうことが望ましい。熱処理温度が750°Cを超えるとGaAs層へのInの拡散速度が大きくなりすぎ、コンタクト層中のIn濃度が過剰となりやすくなる。また、In濃度が飽和して、コンタクト層の厚さ方向に傾斜したIn濃度分布も得にくくなる。いずれも、コンタクト層と発光層部との格子整合が悪化することにつながる。また、GaAs層へのInの拡散が過度に進みすぎると、コンタクト層との接触部付

近にてITO層のInが枯渇し、電極の電気抵抗値の上昇が避けがたくなる。さらに、熱処理温度が上記のように高温になりすぎると、ITOの酸素がGaAs層へ拡散して酸化が促進され、素子の直列抵抗が上昇しやすくなる。いずれも適正な電圧で発光素子を駆動できなくなる不具合につながる。また、熱処理温度が極端に高くなると、ITO層の導電率がかえって損なわれる場合がある。他方、熱処理温度が600℃未満になると、GaAs層へのInの拡散速度が小さくなりすぎ、接触抵抗を十分に低下させたコンタクト層を得るのに非常な長時間を要するようになるので、製造能率の低下が甚だしくなる。

#### 【0034】

また、熱処理時間は、5秒以上120秒以下の短時間に設定することが望ましい。熱処理時間が120秒以上になると、特に、熱処理温度が上限値に近い場合、GaAs層へのInの拡散量が過剰となりやすくなる（ただし、熱処理温度を低めに留める場合は、これよりも長い熱処理時間（例えば300秒程度まで）を採用することも可能である）。他方、熱処理時間が5秒未満になると、GaAs層へのInの拡散量が不足し、接触抵抗を十分に低下させたコンタクト層が得にくくなる。そして、GaAs層にInを拡散させる熱処理を、600℃以上750℃以下の温度で5秒以上120秒以下実施することで、例えば金属層側のAuと基板側のSiとの共晶反応も十分抑制でき、ひいては該熱処理後の金属層の反射率を高く維持することができる。

#### 【0035】

また、コンタクト層の、透明導電性酸化物層に接しているのと反対側の主表面には、中間層を介して発光層部を結合することができる。該中間層は、発光層部とコンタクト層との中間のバンドギャップエネルギーを有する化合物半導体により構成される。ダブルヘテロ構造の発光層部は、活性層へのキャリア閉じ込め効果を高めて内部量子効率を向上させるために、クラッド層と活性層との間の障壁高さを一定以上に高める必要がある。図10の模式バンド図（Ecは伝導帯底、Evは価電子帯頂の核エネルギーレベルを示す）に示すように、このようなクラッド層（例えばAlGaInP）にコンタクト層（例えばInGaAs）を直接接合すると、クラッド層とコンタクト層との間に、接合によるバンドの曲がりに

より、比較的高いヘテロ障壁が形成される場合がある。この障壁高さ $\Delta E$ は、クラッド層とコンタクト層との間のバンド端不連続値が大きくなるほど高くなり、キャリアの移動、特に有効質量のより大きいホールの移動を妨げやすくなる。例えば金属電極を使用する場合は、クラッド層の全面を金属電極で覆うと光取出しができなくなるので、部分的な被覆となるように電極形成せざるを得ない。この場合、光取出し効率向上のため、電極の面内方向外側への電流拡散を何らかの形で促進しなければならない。例えば、金属電極の場合も、発光層部との間にG a A s等のコンタクト層が形成されることが多いが、金属電極の場合は、コンタクト層と発光層部との間に、ある程度高い障壁が形成された方が、障壁によるキャリアのせき止め効果により面内方向の電流拡散を促進できる利点がある。しかし、高い障壁形成のため、直列抵抗の増加は避け難い。

### 【0036】

これに対し、ITO透明電極層を用いる場合は、ITO透明電極層自体が非常に高い電流拡散能を有しているため、障壁によるキャリアのせき止め効果はほとんど考慮する必要がない。しかも、ITO透明電極層の採用により、光取出領域の面積は金属電極使用時と比較して大幅に増加している。そこで、図11に示すように、コンタクト層とクラッド層との間に、それらコンタクト層とクラッド層との中間のバンドギャップエネルギーを有する中間層を挿入すると、コンタクト層と中間層、及び中間層とクラッド層とのそれぞれはバンド端不連続値が小さくなるので、各々形成される障壁高さ $\Delta E$ も小さくなる。その結果、直列抵抗が軽減されて、低い駆動電圧にて十分に高い発光強度を達成することが可能となる。

### 【0037】

上記中間層を採用することによる効果は、ダブルヘテロ構造の発光層部の中でも、特にコンタクト層をなすI nを含有したG a A sとの格子整合性が比較的良好なA l G a I n Pにて発光層部を形成する場合に顕著である。発光層部が、(A l<sub>x</sub> G a<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub> I n<sub>1-y</sub> P (ただし、0≤x≤1, 0≤y≤1) よりなる場合、中間層を、A l G a A s層、G a I n P層及びA l G a I n P層のうち少なくとも一つを含むものとして形成することができ、例えばA l G a A s層を含むものとして形成することができる。また、中間層は、A l G a I n P以外の

発光層部、例えば、 $In_xGa_yAl_{1-x-y}N$ からなるダブルヘテロ構造の発光層部にも適用可能である。この場合、中間層は、例えば $InGaAlN$ 層（バンドギャップエネルギーがクラッド層より小さくなるように組成調整されたもの）を含むものが採用可能である。

### 【0038】

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を添付の図面を参照して説明する。

図1は、本発明の一実施形態である発光素子100を示す概念図である。発光素子100は、導電性基板であるn型Si（シリコン）単結晶基板7の主表面MP2上に、該n型Si単結晶基板7側のAu層（金属層：Au系金属層）40と、これと接する発光層部24側のITO層（接合用透明導電性酸化物層）10とを介して、発光層部24が貼り合わされた構造を有してなる。また、発光層部24の主表面MP4の全面が、光取出面側の電極をなすITO層（電極用透明導電性酸化物層）20により覆われている。ITO層20は、電流拡散層及び光取出層の機能も有し、その主表面MP1の略中央に、発光層部24に発光駆動電圧を印加するための金属電極（例えばAu電極）9が、前記主表面MP1の一部を覆うように形成されている。ITO層20の主表面MP1における、金属電極9の周囲の領域は、発光層部24からの光取出領域をなす。

### 【0039】

発光層部24は、ノンドープ( $Al_xGa_{1-x}$ )<sub>y</sub> $In_{1-y}P$ （ただし、 $0 \leq x \leq 0.55$ ,  $0.45 \leq y \leq 0.55$ ）混晶からなる活性層5を、p型( $Al_zGa_{1-z}$ )<sub>y</sub> $In_{1-y}P$ （ただし $x < z \leq 1$ ）からなるp型クラッド層6（第一導電型クラッド層）とn型( $Al_zGa_{1-z}$ )<sub>y</sub> $In_{1-y}P$ （ただし $x < z \leq 1$ ）からなるn型クラッド層4（第一導電型クラッド層）とにより挟んだ構造を有し、活性層5の組成に応じて、発光波長を、緑色から赤色領域（発光波長（中心波長が550nm以上650nm以下）にて調整できる。図1の発光素子100では、金属電極9側にp型 $AlGaInP$ クラッド層6が配置されており、ITO層10側にn型 $AlGaInP$ クラッド層4が配置されている。従って、通電極性は金属電極9側が正である。なお、ここでいう「ノンドープ

」とは、「ドーパントの積極添加を行なわない」との意味であり、通常の製造工程上、不可避的に混入するドーパント成分の含有（例えば1013～1016/cm<sup>3</sup>程度を上限とする）をも排除するものではない。

#### 【0040】

Si単結晶基板7は、Si単結晶インゴットをスライス・研磨して製造されたものであり、その厚みは例えば100μm以上500μm以下である。そして、発光層部24に対し、金属層40を介して貼り合わされている。金属層40の厚さは例えば100nm以上1000nm以下が望ましい。

#### 【0041】

ITO層20と発光層部24との間及びITO層10と発光層部24との間には、それぞれ、Inを含有したGaAsよりなるコンタクト層30が形成されている。コンタクト層30は、光吸収の影響を小さくするため、その厚さを1nm以上20nm以下（望ましくは5nm以上10nm以下）とする。

#### 【0042】

以下、図1の発光素子100の製造方法について説明する。

まず、図2の工程1に示すように、発光層成長用基板をなす半導体単結晶基板であるGaAs単結晶基板1の主表面MP5に、p型GaAsバッファ層2を例えば0.5μm、さらにAlAsからなる剥離層（図示せず）を例えば0.5μmエピタキシャル成長させる。次いでGaAs層30'（後に、ITO層20とのコンタクト層30となる）を形成し、さらに発光層部24として、1μmのp型AlGaInPクラッド層6、0.6μmのAlGaInP活性層（ノンドープ）5、及び1μmのn型AlGaInPクラッド層4を、この順序にエピタキシャル成長させる。そして、最後にGaAs層30'（後にITO層10とのコンタクト層30となる）を形成する。

#### 【0043】

次に、工程2に示すように、GaAs層30'を形成した発光層部24の主表面MP4に、スパッタリングによりITO層10を形成する。他方、工程3に示すように、別途用意したSi単結晶基板7の主裏面MP2にはAu層40を形成する。そして、Si単結晶基板7のAu層40を、発光層部24側のITO層1

0に重ね合わせて圧迫し、工程4に示すように、所定の条件にて熱処理することにより、基板貼り合わせ体50を作る。

#### 【0044】

Au層40はITO層10の介在により発光層部24と直接接しないので、発光層部24との合金化は生じない。また、上記貼り合わせ熱処理や後述のGaAs層30'へのIn拡散処理時にも、ITO層10との過度な化学反応を生じにくく、貼り合わせ後も良好な金属光沢を維持し、高反射率を実現できる。当然、従来のように、Au層40と発光層部24との接触抵抗低減のための合金加熱処理も全く不要である。

#### 【0045】

なお、上記の貼り合わせ熱処理により、Au層40とITO層10との貼り合わせ結合力はおおむね十分なものが得られ、両者の接触抵抗も、実用上支障ない程度に十分低下できる。しかし、図1に示すように、Au層40のITO層10と接触する最表層部を少なくとも、Snを含有したAu-Sn合金層40aにて構成しておけば、貼り合わせ結合力をさらに高めることができ、また、良好なオーミックコンタクトをより得やすくなる。

#### 【0046】

図2に戻り、次に、工程5に進み、上記基板貼り合わせ体50を、例えば10%フッ酸水溶液からなるエッティング液に浸漬し、バッファ層2と発光層24との間に形成した前記AlAs剥離層を選択エッティングすることにより、GaAs単結晶基板1（発光層24からの光に対して不透明である）を、発光層部24とこれに接合されたSi単結晶基板7との積層体50aから剥離して除去する。なお、AlAs剥離層に代えてAlInPよりなるエッチストップ層を形成しておき、GaAsに対して選択エッティング性を有する第一エッティング液（例えばアンモニア／過酸化水素混合液）を用いてGaAs単結晶基板1をGaAsバッファ層2とともにエッティング除去し、次いでAlInPに対して選択エッティング性を有する第二エッティング液（例えば塩酸：Al酸化層除去用にフッ酸を添加してもよい）を用いてエッチストップ層をエッティング除去する工程を採用することもできる。このように、発光層成長用基板を全てエッティングにより除去することも、「

剥離」の概念に属するものとする。

#### 【0047】

そして、工程6に示すように、GaAs単結晶基板1の剥離により露出したGaAs層30'の主裏面MP3(p型クラッド層6側)の全面を覆うようにITO層20を形成する。GaAs層30'（後のコンタクト層30）は、光吸収の影響を小さくするため、その厚さを1nm以上20nm以下（望ましくは5nm以上10nm以下）とする。なお、コンタクト層30は、最終的にはInを含有したGaAs層、具体的にはITO層10, 20との界面側が（少なくとも）、InGaAsとなるものであり、例えばMOVPE法等により直接エピタキシャル成長して形成することも可能であるが、Inを含有したITO層10あるいは20と接して形成することを考慮すれば、以下のようなより簡便な製造方法を採用することが可能である。すなわち、上記のようにGaAs層30'を形成した後、これを覆うITO層10, 20を形成する。

#### 【0048】

そして、図3に示すように、ITO層10, 20を形成した積層体ウェーハ13を炉Fの中に配置し、例えば窒素雰囲気中あるいはAr等の不活性ガス雰囲気中にて、600°C以上750°C以下（例えば700°C）の低温で、5秒以上120秒以下（例えば30秒）の短時間の熱処理を施す。これにより、ITO層10, 20から各GaAs層30'にInが拡散し、Inを含有したGaAsよりなるコンタクト層30（図1）が得られる。

#### 【0049】

該熱処理により得られるコンタクト層30は、図4①において、ITO層10, 20との界面近傍におけるIn濃度が、InとGaとの合計濃度に対するInの原子比にて、0.1以上0.6以下とされる。また、In濃度は、ITO層から厚さ方向に遠ざかるにつれ連続的に減少するものとなっており、ITO層との各境界位置におけるIn濃度をCAとし、これと反対側の境界位置におけるIn濃度をCBとしたとき、CB/CAが0.8以下となるように調整されている。

#### 【0050】

コンタクト層30は、AlGaInPよりなる発光層部24に対し、格子整合

性の良好な GaAs 層 30' をまず形成し、その後、比較的低温で短時間の熱処理を施すことにより、In 含有量が過剰でなく、しかも均質で連続性の良好なものとなる。その結果、発光層部 24 との格子不整合による、発光強度低下などの品質劣化を効果的に防止することができる。

### 【0051】

コンタクト層 30 は、適当なドーパントの添加 (GaAs 層 30' の段階でドーピングしておく) により、これと接するクラッド層 4, 6 とそれぞれ同じ導電型を有するものとして形成してもよいが、コンタクト層 30 を上記のような薄層として形成する場合は、これらをドーパント濃度の低い低ドープ層 (例えば 1017 個/cm<sup>3</sup> 以下; あるいはノンドープ層 (1013 個/cm<sup>3</sup> ~ 1016 個/cm<sup>3</sup>)) として形成しても直列抵抗の過度の増加を招かないので、問題なく採用可能である。他方、低ドープ層とした場合、発光素子の駆動電圧によっては、以下のような効果が達成できる。すなわち、コンタクト層 30 を低ドープ層とすることで、層の電気抵抗率自体は高くなるので、これを挟む電気抵抗率の小さいクラッド層あるいは ITO 層 10, 20 に対して、コンタクト層 30 の層厚方向に印加される電界 (すなわち、単位距離当たりの電圧) が相対的に高くなる。このとき、コンタクト層 30 を、バンドギャップの比較的小さい In を含有した GaAs により形成しておくと、上記電界の印加によりコンタクト層のバンド構造に適度な曲がりが生じ、より良好なオーミック状接合を形成することができる。そして、図 5 に示すように、コンタクト層 30 の In 濃度が、ITO 層 10, 20 との接触側にて高められていることで、該効果が一層顕著なものとなる。

### 【0052】

こうしてコンタクト層 30 及び ITO 層 20 の形成が終了すれば、Au 等によるワイヤボンディング用の金属電極 9 (ボンディングパッド: 図 1) を ITO 層 20 上に形成する。以下、通常の方法によりダイシングして半導体チップとし、これを支持体に固着してリード線のワイヤボンディング等を行なった後、樹脂封止をすることにより最終的な発光素子が得られる。

### 【0053】

なお、コンタクト層 30 は、図 6 の発光素子 200 のように、(ボンディング

パッド：図1）の直下領域をなす光取り出し量が少ない第一領域には形成されず、その周囲の光取り出し量が多い第二領域にのみ選択的に形成することもできる。図6では、該第二領域においてコンタクト層30を、その形成領域と非形成領域とが混在した形としてある。従って、コンタクト層30の非形成領域においてはITO層20が発光層部24と直接接触する形となっている。

#### 【0054】

図7（a）～（c）に示すように、コンタクト層30の形成領域は、ITO層20の接合界面において分散形成することにより、発光層部24における発光を均一化し、かつコンタクト層30の非形成領域から均一に光を取り出すことができる。図7（a）はコンタクト層30の形成領域を散点状とした例であり、（b）は細長い帯状のコンタクト層30の形成領域と、同形態の非形成領域とを交互に形成した例である。さらに、（c）は、（a）とは逆に、コンタクト層30の形成領域を背景として、散点状の非形成領域をこれに分散形成した例である。ここではコンタクト層30の形成領域を格子状に形成している。いずれも、周知のフォトリソグラフィー工程により、コンタクト層30のパターニングが可能である。

#### 【0055】

なお、コンタクト層とAlGaInP層とを直接接合した場合、接合界面にやや高いヘテロ障壁が形成され、これに起因して直列抵抗成分が増大する場合がある。そこで、これを低減する目的で、図8及び図9の発光素子300, 400に示すようにITO層10, 20と接するコントラクト層30と、発光層部24（クラッド層4, 6）との間に、両者の中間のバンドギャップエネルギーを有する中間層31を挿入することができる。中間層31は、例えばAlGaAs、GaInP及びAlGaInPの少なくとも1つを含むものとして構成でき、例えば中間層の全体を单一のAlGaAs層として構成できる。この構造を採用する場合でも、それら中間層の厚さはそれぞれ0.1μm程度以下（0.01μm以上：これ以上薄くなると、バルクのバンド構造が失われ、所期の接合構造が得られなくなる）とすることが可能なため、薄層化によるエピタキシャル成長時間の短縮、ひいては生産性の向上を図ることができ、中間層形成による直列抵抗の増

分も少なくできるため、発光効率も損なわれにくい。特に、電極用透明導電性酸化物層をなすITO層20（本実施形態では、発光再結合確率の高いp型クラッド層6側である）の一部領域のみにコンタクト層30を形成する場合は、発光通電の際の電流密度はこれらコンタクト層30の形成領域において選択的に高くなる傾向にある。もし、コンタクト層30とAlGaInPクラッド層6との間に形成されるヘテロ障壁が高いと、電流集中の影響により、該コンタクト層30とクラッド層6との接合界面を通過する際の電圧降下が一層甚だしくなり、見かけの直列抵抗がより大きくなりやすい問題がある。従って、コンタクト層30をITO層20の全面に形成する場合よりも、中間層31の形成によりヘテロ障壁高さを減ずることの効果が一層顕著であるといえる。

#### 【0056】

なお、中間層31は、厚さがごく小さい場合など、光吸収にそれほど悪影響を及ぼす心配が無い場合は、図8の発光素子300のように、発光層部24の全面を覆うように形成することができる。このようにすると、コンタクト層30のみをパターニングすればよいので、例えば化学エッチングの場合、コンタクト層30に対するエッチャントにて中間層31を十分にエッチングできない場合でも、製造が容易である。他方、図9の発光素子400のように、中間層31をコンタクト層30の形成領域にのみ形成することもでき、中間層31による光吸収の影響をより小さくすることができる。この場合、コンタクト層30と中間層31とを発光層部24の全面を覆うように形成しておき、前述のフォトリソグラフィーにより、両者を各々パターニングすればよい。この場合は、気相エッチングによりコンタクト層30と中間層31とを同時にエッチングしてもよいし、化学エッチングの場合は、コンタクト層30と中間層31とでエッチャントを交換して順次エッチングを行なうことも可能である。

#### 【0057】

なお、ITO層20は、透明導電性酸化物であるITOにて構成され、光取出機能と電流拡散機能とを両立した透明電極として機能する。電流拡散機能を高めるには、ITO層20のシート抵抗（あるいは電気比抵抗）を低減することが重要であり、また、光取出機能を高めるには、必要に応じてITO層20を厚く形

成した場合でも、十分な光透過性が確保できるようにすることが重要である。例えばITO層20をスパッタリングにより形成する場合、シート抵抗を低減するには、スパッタリング電圧をなるべく低く設定することが望ましい。これは、スパッタリングのプラズマ中に含まれる負イオン（主に酸素イオンである）が堆積中のITO層に高速で入射すると、絶縁性のInOが形成されやすくなるが、加速電圧が低くなると該InOの形成が抑制されるためである。このようなスパッタリングの低電圧化を図るために、スパッタリング時の磁界強度を一定以上に高めること（例えば、0.8kG以上：電圧低減効果が飽和するので2000G以下で設定することが望ましい）が有効である。シート抵抗の低減は、例えばカソード電圧の絶対値にて350V以下、望ましくは250V以下に設定することで顕著となる。磁界強度を例えば1000G以上に設定すれば、スパッタリング電圧をカソード電圧の絶対値にて250V以下に容易に調整することができる。

#### 【0058】

均質で光透過率の高いITO層を得るには、また、発光層部と透明導電性半導体基板とを容易かつ強固に貼り合わせるために、ITO層を、明確な結晶粒界が形成されない非晶質層とすることが有利である。非晶質のITO層を得るには、ITOの結晶化を防止するため200°C以下の低温で成膜を行なう必要がある。この場合、低抵抗のITO層を得るために、上記のスパッタリング条件と組み合わせることが有効であり、特に、低温でも均質で低抵抗率のITO層を得るには、スパッタリング雰囲気中に水蒸気を導入することが有効である（例えば $3 \times 10^{-3}$ Pa以上 $15 \times 10^{-3}$ Pa以下）。スパッタリング雰囲気の水蒸気分圧が過度に低くなると、得られるITO層の微結晶化が進みやすくなり、光透過率の低下及びシート抵抗の上昇が著しくなるが、一定以上の水蒸気分圧を確保することで、この微結晶化を効果的に抑制することができる。これにより、光透過率が90%以上（望ましくは95%以上）、比抵抗が $1000 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ 以下（望ましくは $800 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ 以下）のITO層を実現できるようになる。

#### 【0059】

また、ITO層20は、均一で大きな電流拡散効果を有していることが、均一で高い発光効率を実現する上で重要である。そのためには、ITO層を均質で低

抵抗率のものとして構成する以外に、その表面の平滑性を高めることが必要となる。表面の平滑性が低下すると、電界集中しやすい突起部が多数形成されやすくなり、発光層部24への印加電圧の不均一化により局所的な暗所を生じやすくなったり、あるいはリーク電流の発生により発光効率そのものが低下することにつながる。これらの不具合防止のため、ITO層の表面粗さは、具体的には、原子間力顕微鏡（AFM）による3次元表面トポグラフィーにて、評価面積を0.2 $\mu\text{m}$ 四方としたときのR<sub>max</sub>の値にて10nm以下とすること（例えば4nm以上7nm以下）に設定することが望ましい。

#### 【0060】

上記のようなITO層の表面平滑化のためには、ITO層を形成したあと、その表面を研磨することが有効であるが、機械的な研磨は高コストなので化学研磨の採用が望ましい。ITOの化学研磨液としては、例えば塩酸と硝酸の混合液や、亜硝酸水溶液を採用できる。この場合、前述のようなITO層の微結晶化が進むと、結晶粒界でエッチングが進行しやすいため、粒界侵食や脱粒による表面粗化を生じやすくなる。従って、均質な非晶質層を得るために、スパッタリング雰囲気中への水蒸気を導入することは、化学研磨後のITO層の表面粗さを上記のように低減する上でも有力な手法となりうる。

#### 【0061】

例えば、大面積の面発光型素子の発光強度を最大限に高めるためには、大面積のITO層にできるだけ大きな電流を均一に流すことが重要である。従って、大面積の面発光型素子に本発明を適用する場合には、上記のように平滑かつ低抵抗率であり、かつ、光透過率の高いITO層を採用することが特に有利であるといえる。

#### 【0062】

なお、電極用透明導電性酸化物層をなすITO層20に代え、図12の発光素子500のように、GaP等の化合物半導体よりなる電流拡散層45を設けてもよい。

#### 【0063】

以上説明した実施形態では、発光層部24の各層をAlGaInP混晶にて形

成していたが、該各層（p型クラッド層、活性層及びn型クラッド層）をAlGaInN混晶により形成することにより、青色あるいは紫外発光用のワイドギャップ型発光素子を構成することもできる。発光層部は、図1の発光素子100と同様にMOVPE法により形成される。この場合、発光層部を成長させるための発光層成長用基板をなす半導体単結晶基板は、GaaS単結晶基板に代えて、例えばサファイア基板（絶縁体）が使用される。

#### 【0064】

さらに、活性層5は上記実施形態では単一層として形成していたが、これを、バンドギャップエネルギーの異なる複数の化合物半導体層が積層されたもの、具体的には、量子井戸構造を有するものとして構成することもできる。量子井戸構造を有する活性層は、混晶比の調整によりバンドギャップが互いに相違する2層、すなわちバンドギャップエネルギーの小さい井戸層と大きい障壁層とを、各々電子の平均自由行程もしくはそれ以下の厚さ（一般に、1原子層～数nm）となるように格子整合させる形で積層したものである。上記構造では、井戸層の電子（あるいはホール）のエネルギーが量子化されるため、例えば半導体レーザー等に適用した場合に、発振波長をエネルギー井戸層の幅や深さにより自由に調整でき、また、発振波長の安定化、発光効率の向上、さらには発振しきい電流密度の低減などに効果がある。さらに、井戸層と障壁層とは厚さが非常に小さいため、2～3%程度までであれば格子定数のずれが許容され、発振波長領域の拡大も容易である。なお、量子井戸構造は、井戸層を複数有する多重量子井戸構造としてもよいし、井戸層を1層のみ有する单一量子井戸構造としてもよい。なお、障壁層の厚さは、例えばクラッド層と接するもののみ50nm程度とし、他は6nm程度とすることができる。また、井戸層は5nm程度とすることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

本発明の発光素子の第一実施形態を積層構造にて示す模式図。

##### 【図2】

図1の発光素子の製造工程を示す説明図。

**【図3】**

図2に続く工程説明図。

**【図4】**

コンタクト層の一例を示す概念図。

**【図5】**

コンタクト層の変形例を示す概念図。

**【図6】**

本発明の発光素子の第二実施形態を積層構造にて示す模式図。

**【図7】**

図6の発光素子の、コンタクト層の種々のパターニング形態を示す模式図。

**【図8】**

本発明の発光素子の第三実施形態を積層構造にて示す模式図。

**【図9】**

本発明の発光素子の第四実施形態を積層構造にて示す模式図。

**【図10】**

コンタクト層のバンド構造の第一例を示す模式図。

**【図11】**

コンタクト層のバンド構造の第二例を示す模式図。

**【図12】**

本発明の発光素子の第五実施形態を積層構造にて示す模式図。

**【符号の説明】**

- 1 GaAs 単結晶基板 (発光層成長用基板)
- 4 n型クラッド層 (第二導電型クラッド層)
- 5 活性層
- 6 p型クラッド層 (第一導電型クラッド層)
- 7 Si 単結晶基板 (導電性基板)
- 9 金属電極
- 10 ITO層 (接合用透明導電性酸化物層)
- 20 ITO層 (電極用透明導電性酸化物層)

24 発光層部

30 コンタクト層

30' GaAs層

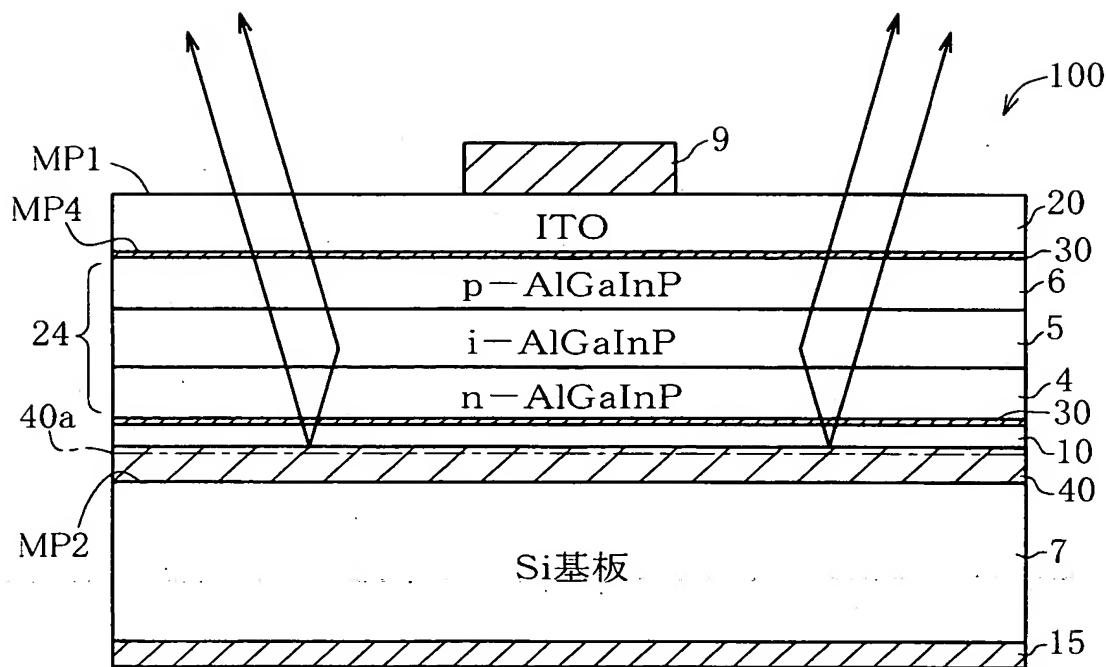
40 Au層 (金属層)

40a Au-Sn合金層 (金属層)

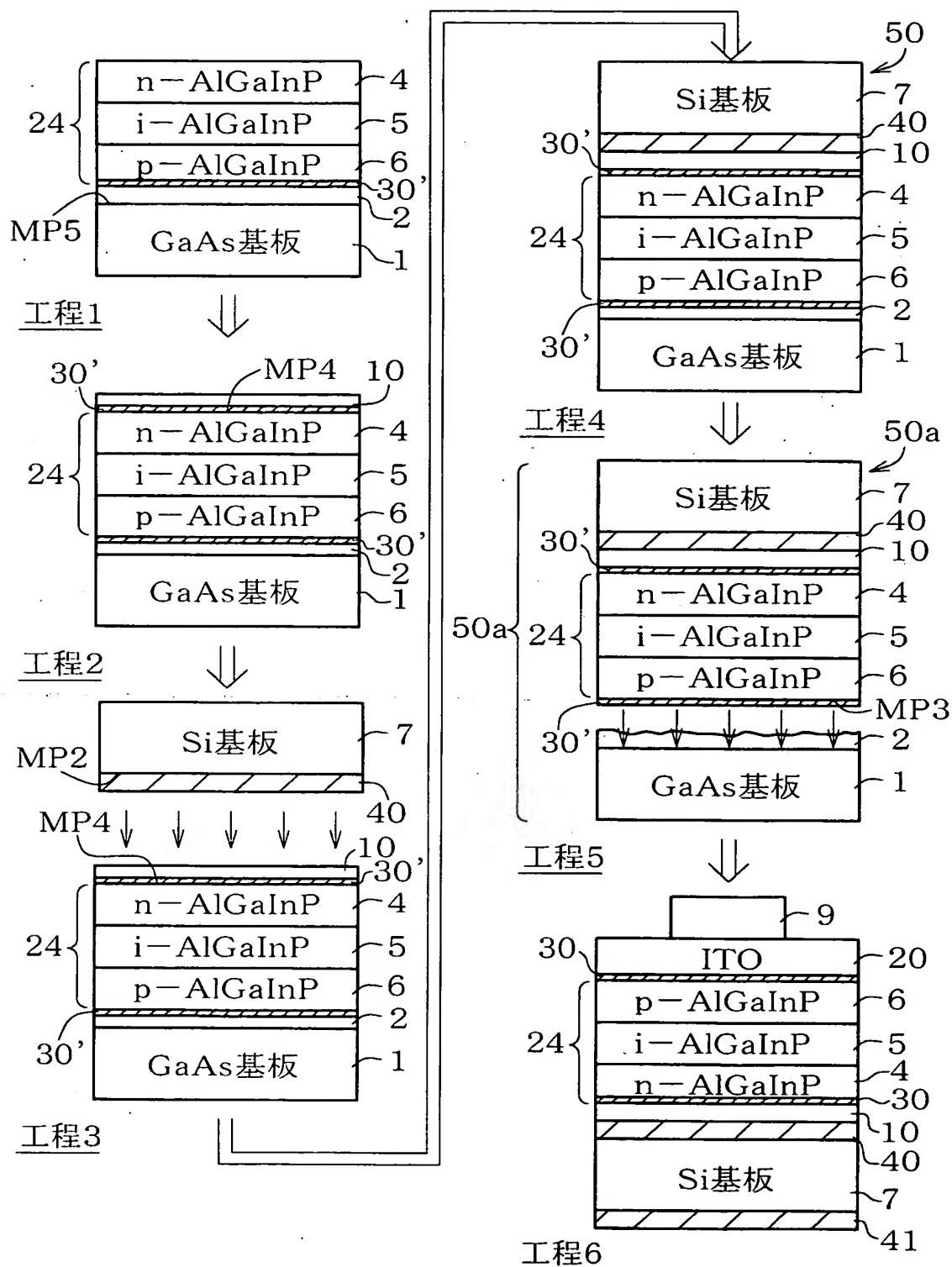
100, 200, 300, 400, 500 発光素子

【書類名】 図面

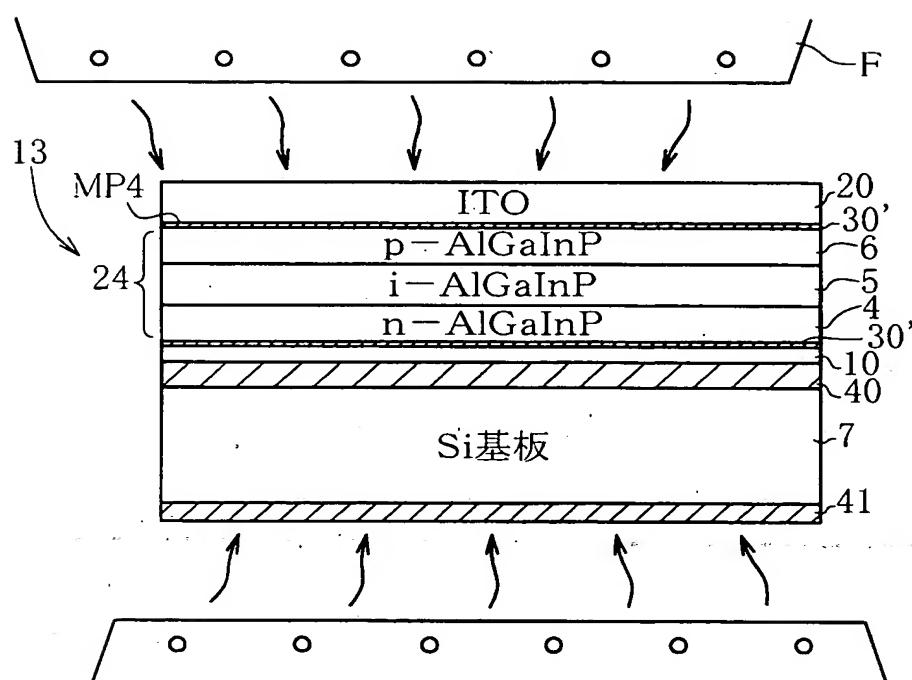
【図1】



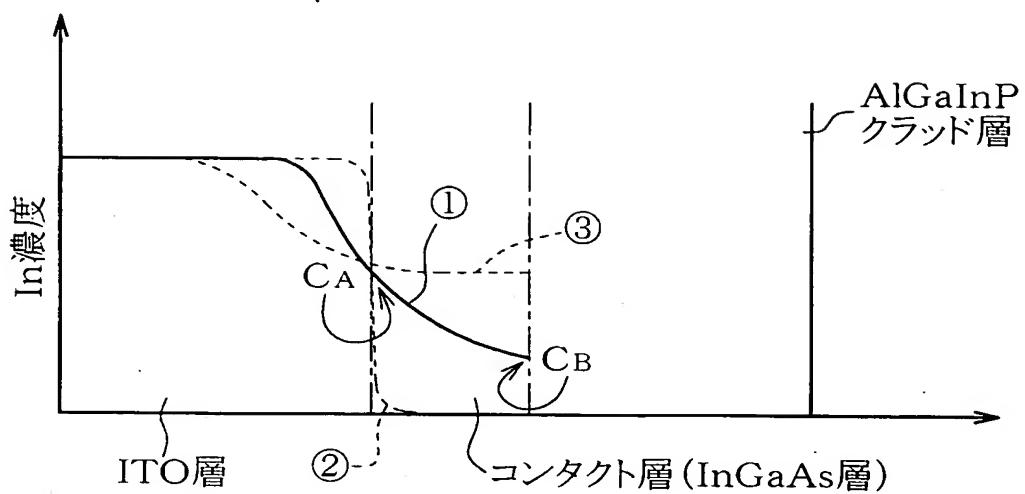
【図2】



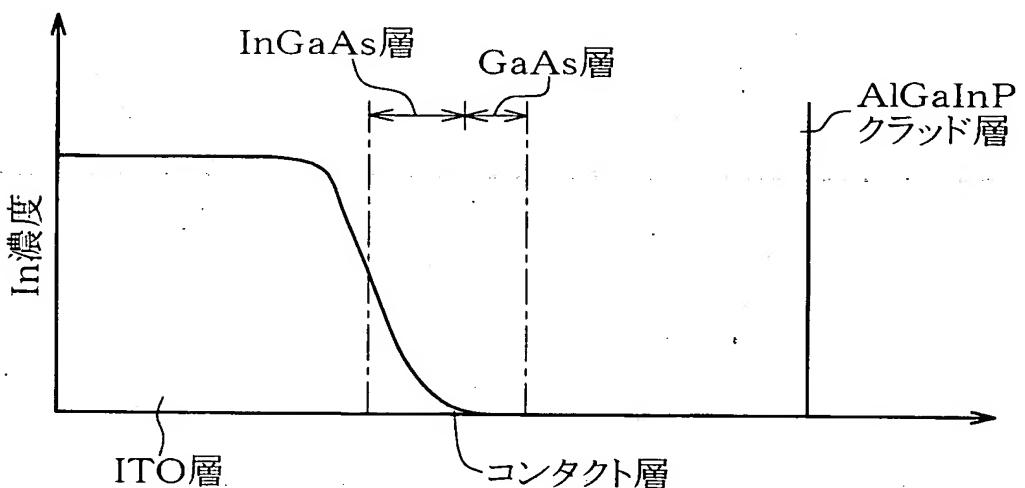
【図 3】



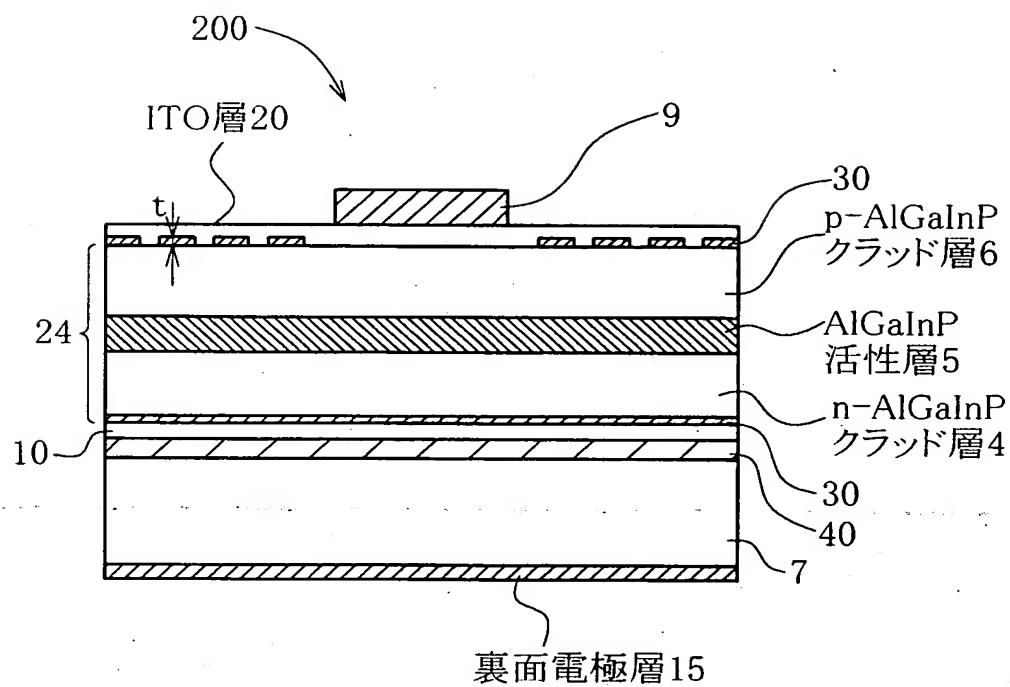
【図 4】



【図 5】

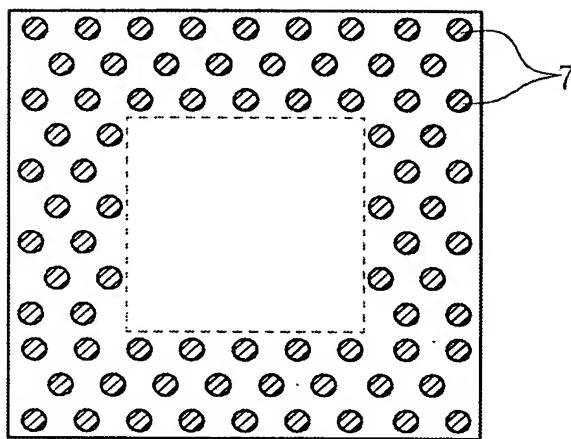


【図6】

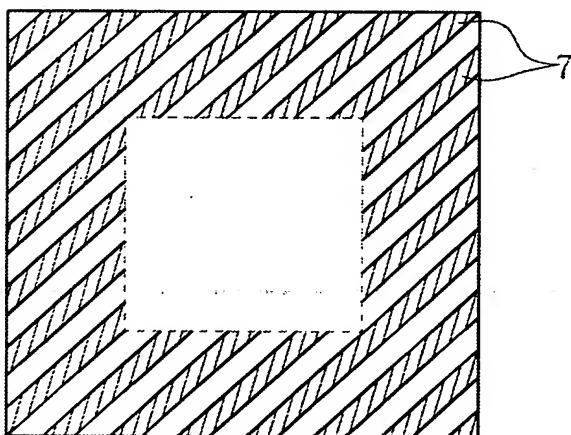


【図7】

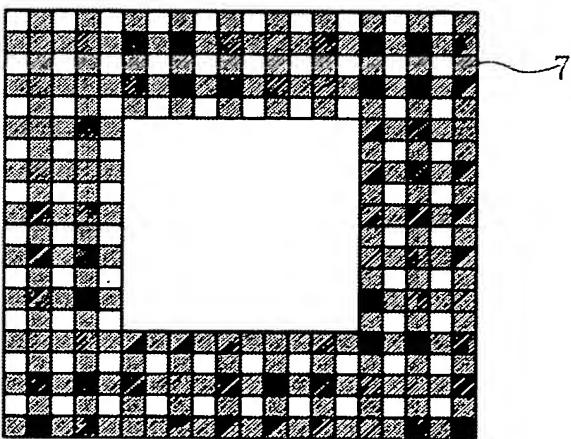
(a)



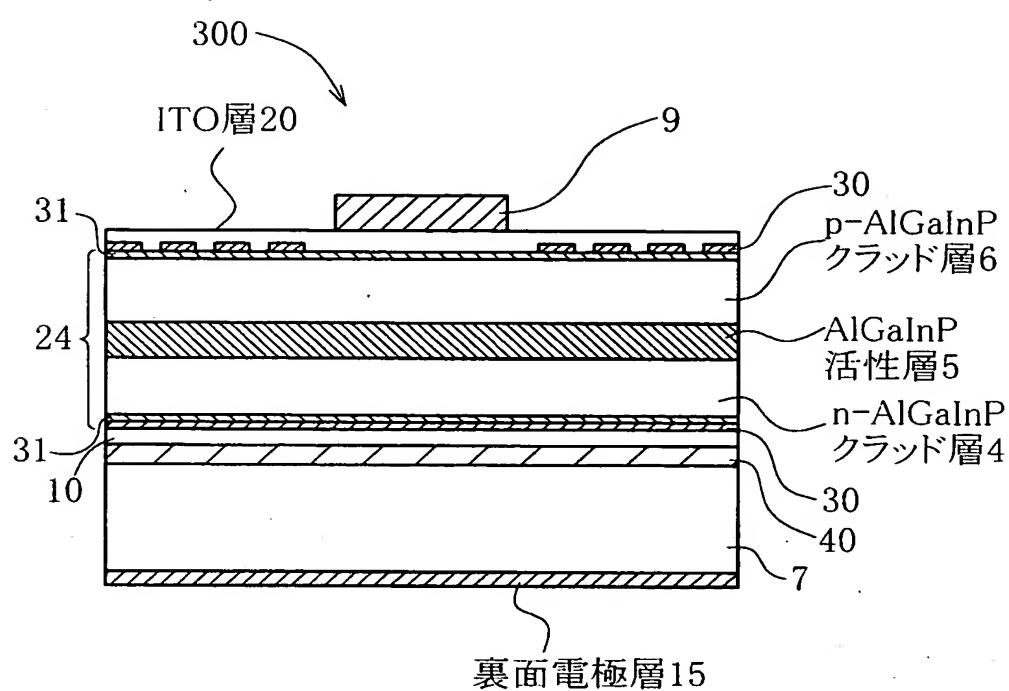
(b)



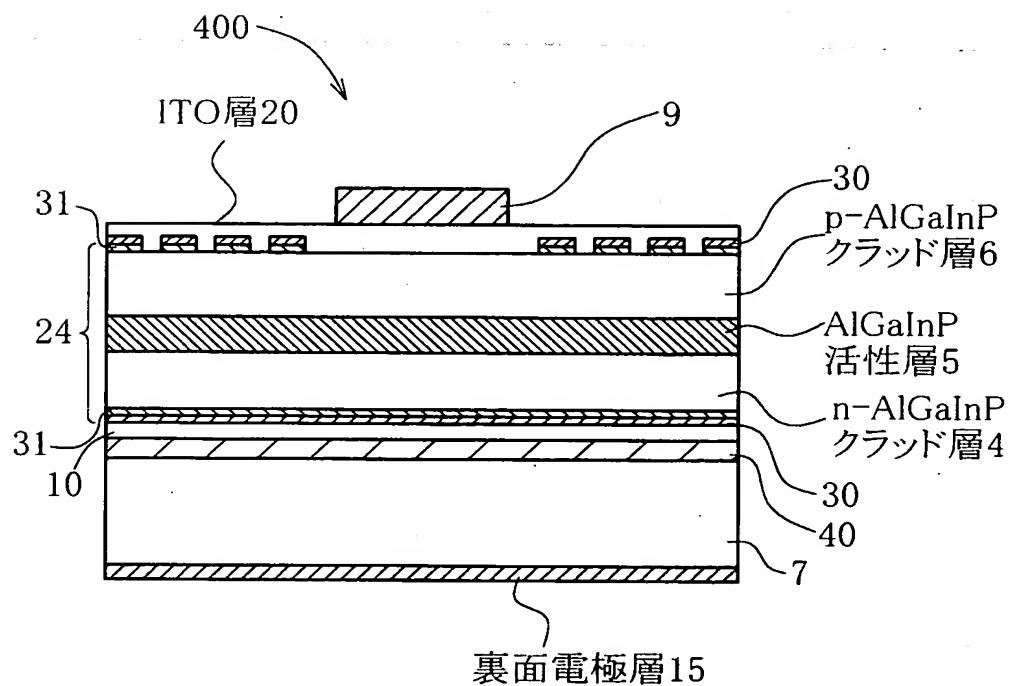
(c)



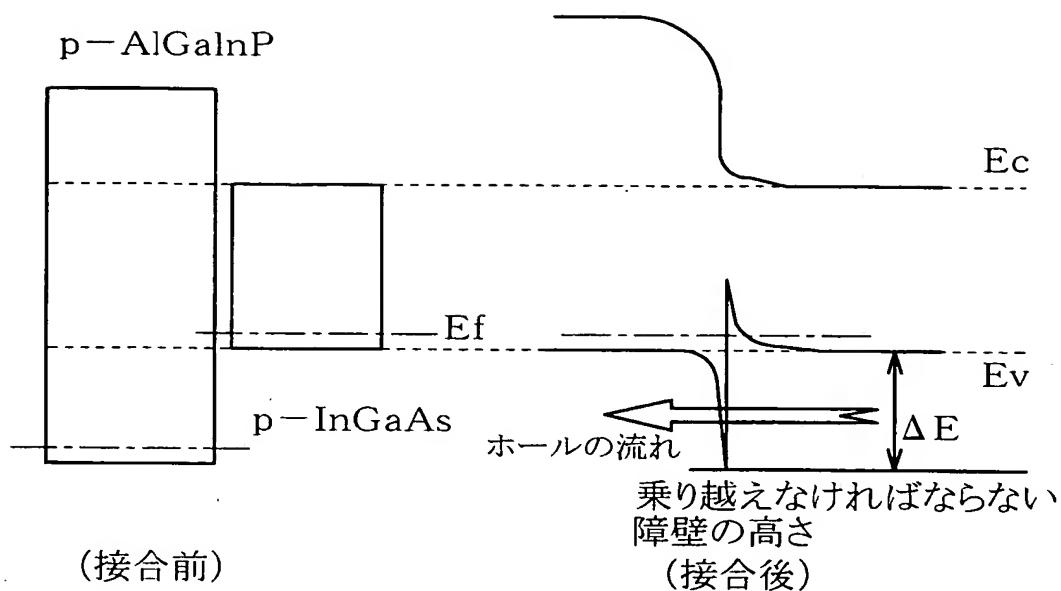
【図 8】



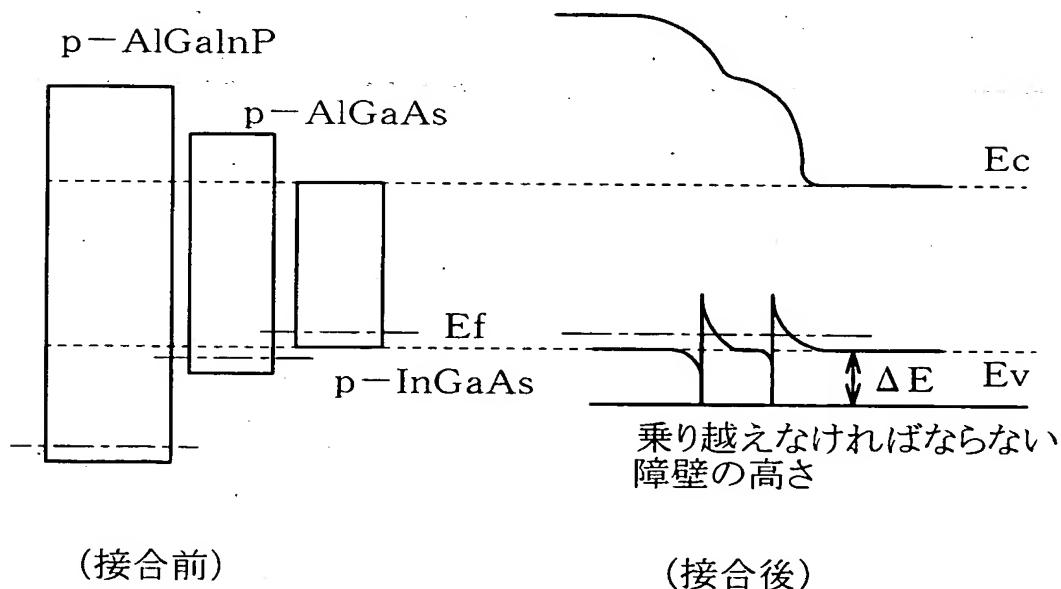
【図 9】



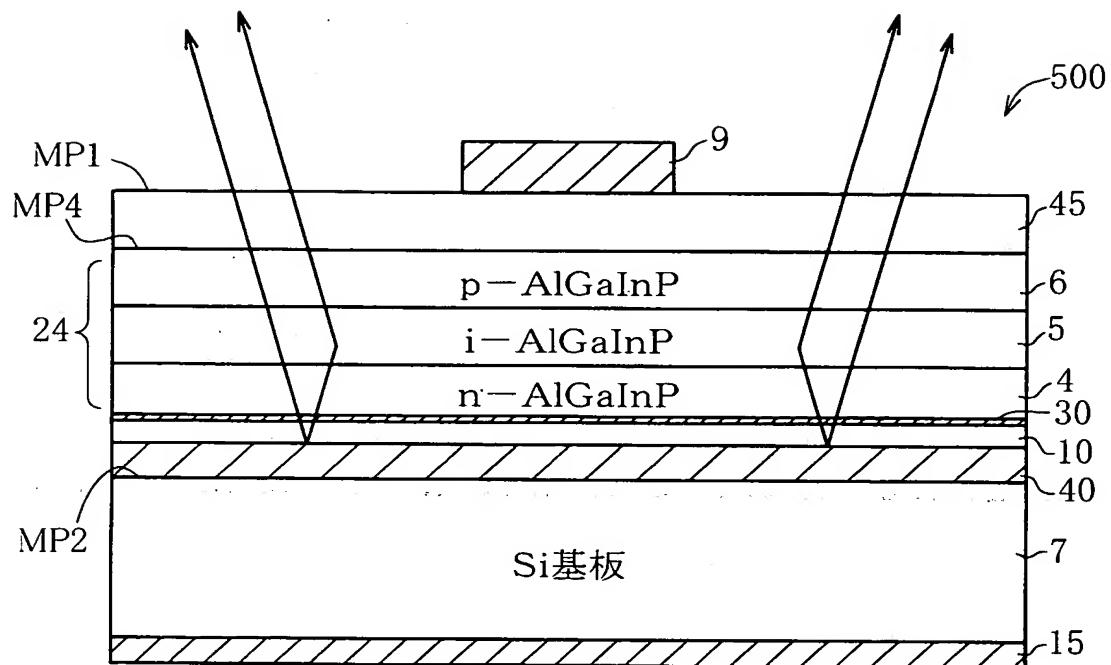
【図10】



【図11】



【図 12】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 金属層を反射層として利用することにより、素子からの光取出し効率が良好であり、金属層と発光層部との合金化による反射率低下の心配がない発光素子を提供する。

【解決手段】 発光素子100は、導電性基板であるn型Si単結晶基板7の主表面MP2上に、該n型Si単結晶基板7側のAu層40と、これと接する発光層部24側のITO層（接合用透明導電性酸化物層）10とを介して、発光層部24が貼り合わされた構造を有する。また、発光層部24の主表面MP4の全面が、光取出面側の電極をなすITO層（電極用透明導電性酸化物層）20により覆われている。ITO層20は、電流拡散層及び光取出層の機能も有し、その主表面MP1の略中央に、発光層部24に発光駆動電圧を印加するための金属電極（例えばAu電極）9が、前記主表面MP1の一部を覆うように形成されている。ITO層20の主表面MP1における、金属電極9の周囲の領域は、発光層部24からの光取出領域をなす。

【選択図】 図1

特願2002-308970

出願人履歴情報

識別番号 [000190149]

1. 変更年月日 1990年 8月 7日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都千代田区丸の内1丁目4番2号  
氏名 信越半導体株式会社

特願2002-308970

出願人履歴情報

識別番号 [501045021]

1. 変更年月日 2001年11月 8日  
[変更理由] 名称変更  
住 所 東京都三鷹市下連雀3丁目38番4号  
氏 名 株式会社ナノテコ

2. 変更年月日 2002年 1月 25日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 東京都三鷹市下連雀3丁目38番地4号 三鷹産業プラザ40  
8  
氏 名 株式会社ナノテコ